证券代码：600870　　证券简称：*ST 厦华　　编号：临 2018-078

厦门华侨电子股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 7 月 24 日开市起停牌。并于 2017 年 8 月 4 日确认构成了重大资产重组。

2017 年 12 月 30 日，公司披露了《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告，并分别于 2018 年 4 月 5 日及 2018 年 4 月 25 日披露了《关于对上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》、《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告。公司股票于 2018 年 4 月 9 日复牌。

截至本公告披露日，公司与相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前交易双方仍在就交易方案调整的具体事项进行谈判中，待相关事项确定后，公司将及时履行信息披露义务，同时将督促相关各方积极推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料的编制工作。待本次交易涉及标的资产审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的各项提案，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序和信息披露义务。

公司披露的《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次发行股份购买资产涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明。公司相关信息均以指定披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日